

## 2025年度 (2026年3月期) 第3四半期決算説明会

2026/02/06

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO

木村 龍一

執行役員常務 CFO

小泉 公人

経営支援室 IRチームリーダー

高嶋 直樹

- ・ **将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ・ **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

## 2025年度 第3四半期累計期間 連結業績

売上高は3Q累計で既往ピーク、営業利益・経常利益・受注高 それぞれ前年同期比で増加

全社業績(億円)		2024年度 第3四半期(累計)	2025年度 第3四半期(累計)	前年同期比
受注高		1,104	1,173	+6%
売上高		1,031	1,130	+10%
営業利益		191	209	+10%
(利益率)		(19%)	(19%)	+0pt
経常利益		198	217	+10%
当期純利益		181	141	-22%
研究開発費		76	85	+12%
設備投資		64	84	+32%
減価償却費		38	41	+8%
セグメント別業績		2024年度 第3四半期(累計)	2025年度 第3四半期(累計)	前年同期比
半導体製造装置	受注高	812	873	+8%
	売上高	774	868	+12%
	営業利益	156	177	+13%
	(利益率)	(20%)	(20%)	+0pt
計測機器	受注高	292	300	+3%
	売上高	258	262	+2%
	営業利益	35	33	-7%
	(利益率)	(14%)	(12%)	-1pt

- CFOの小泉です。日頃大変お世話になっております。
- それでは、2025年度第3四半期の業績を説明させていただきます。
- まず、2ページ、第3四半期累計期間の業績ですが、半導体製造装置、計測機器の両セグメントとも、概ね計画通りに出荷・据付が進みました結果、売上高は、この期間の既往ピークを更新しました。これに伴い、営業利益・経常利益ともに前年同期比で増益となりました。純利益は、第2四半期に特別損失がありましたので、減益の着地でした。
- この期間の受注高も、前年同期比で増加しました。
- セグメント別業績は、下段に記載の通りです。

## 2025年度 第3四半期 連結業績

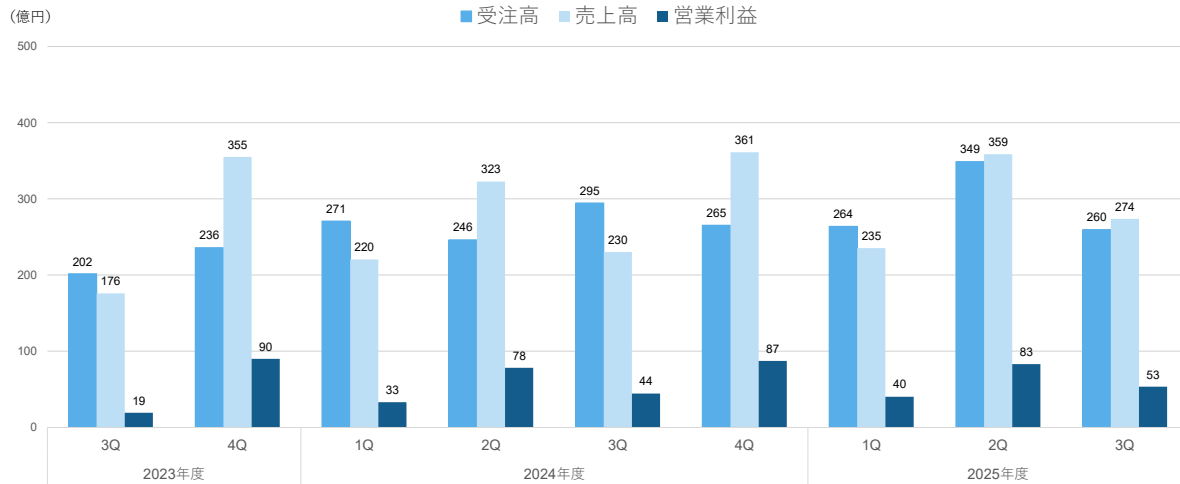
売上高・営業利益は前年同期比で増加、受注高は減少も高水準を維持

全社業績(億円)		2024年度				2025年度			前四半期比	前年同期比
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
受注高		374	337	392	353	359	447	366	-18%	-7%
売上高		296	418	317	474	309	462	359	-22%	+13%
営業利益		41	93	57	106	46	101	62	-39%	+10%
(利益率)		(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	(15%)	(22%)	(17%)	-5pt	-1pt
経常利益		43	88	66	101	45	105	67	-36%	+2%
当期純利益		36	100	46	75	32	64	45	-29%	-1%
研究開発費		23	28	25	28	25	30	29	-3%	+16%
設備投資		28	12	24	39	25	44	15	-66%	-38%
減価償却費		12	13	13	13	12	14	14	-1%	+9%
セグメント別業績		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前四半期比	前年同期比
半導体 製造装置	受注高	271	246	295	265	264	349	260	-26%	-12%
	売上高	220	323	230	361	235	359	274	-24%	+19%
	営業利益	33	78	44	87	40	83	53	-36%	+20%
	(利益率)	(15%)	(24%)	(19%)	(24%)	(17%)	(23%)	(20%)	-4pt	+0pt
計測機器	受注高	103	91	98	87	95	98	107	+9%	+9%
	売上高	76	95	87	113	73	103	85	-17%	-2%
	営業利益	8	15	12	19	5	18	9	-53%	-29%
	(利益率)	(10%)	(16%)	(14%)	(17%)	(7%)	(18%)	(10%)	-8pt	-4pt

- 3ページは、第3四半期、10-12月の3か月間の業績です。
- 上段の全社業績ですが、前の第2四半期との比較では、シクリカルな動きで減収減益の結果となっておりますが、2024年度第3四半期との比較では、概ね増収、営業利益で増益の着地となりました。なお、経常利益以下については、前年第3四半期に為替差益が発生していたため、概ね前年並みとなりました。
- セグメント別の業績は、下段に記載の通りです。

## 半導体製造装置セグメント 業績推移

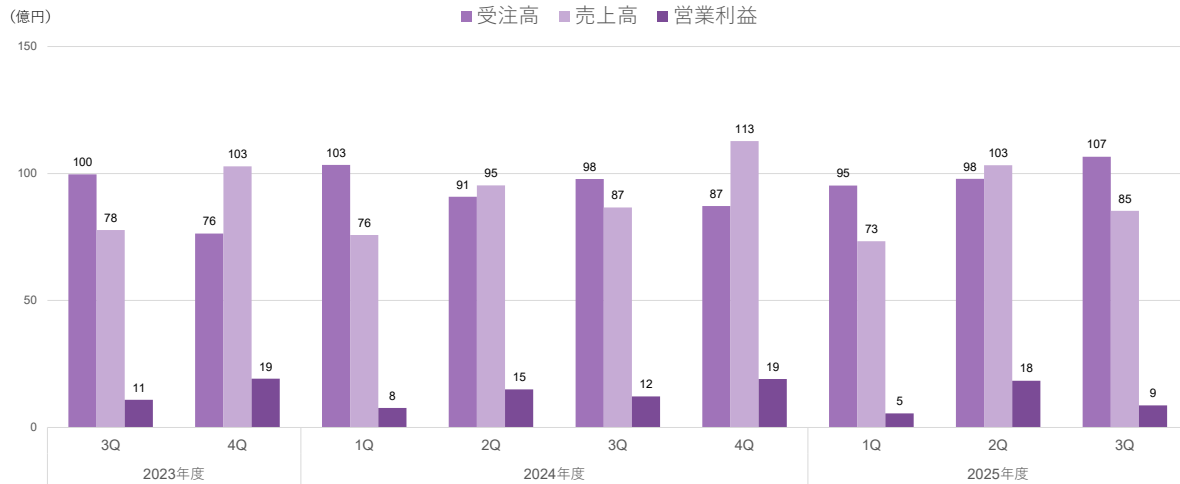
第3四半期の受注高は、概ね想定並み、生成AIを含むHPC需要が底堅く推移  
(HBM向けの高水準の受注があった第2四半期からは減少)



- 4ページは、半導体製造装置の、受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフでまとめたものです。このページでは、受注について説明します。
- 右側、第3四半期、10-12月の受注高は260億円となり、これは概ね会社の想定線内での着地でした。第2四半期に大型のHBM向けプローバ受注があったため、前四半期比では減少していますが、生成AIを含むHPC需要、具体的にはメモリ、ロジックそれぞれのプローバ需要や、AIパッケージング工程向けのグラインダ需要が堅調に推移しました。
- なお、口頭で説明していた生成AIを含むHPC向け需要など、重要性が高いと考えられる情報や、以前は本文で説明していた製品別ブレークダウンは、このプレゼンテーション資料、14ページ以降の補足資料パートに記載する形に変更しましたので、併せてご覧いただけますようお願いいたします。

## 計測機器セグメント 業績推移

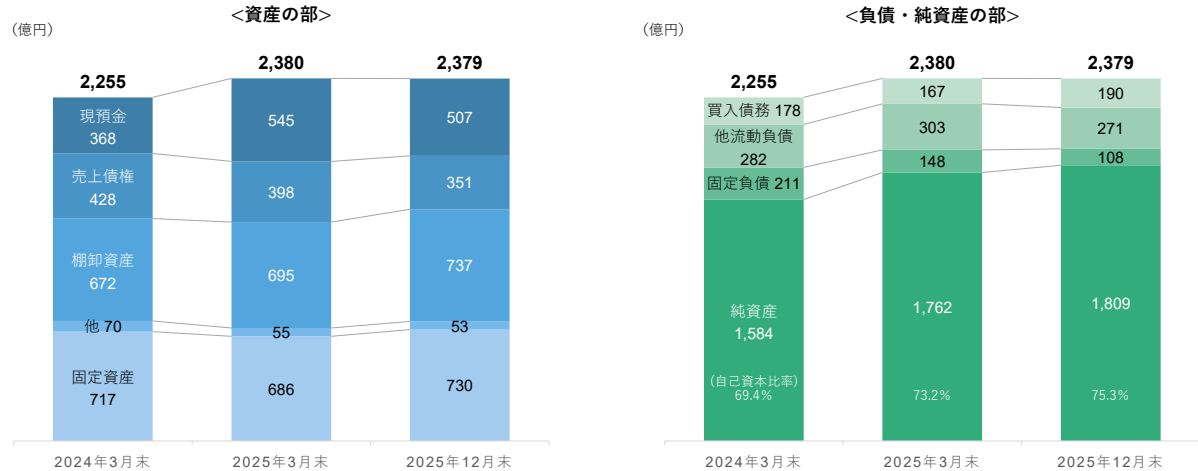
第3四半期の受注高は既往ピークを更新、想定を上振れ(航空宇宙・防衛関連需要を獲得)



- 5ページは、計測機器の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。同様に受注について説明いたします。
- 第3四半期の受注高は107億円で、四半期既往ピークの数字です。従来より、更新需要を安定的に獲得できておりましたが、当社が成長領域と見込んでいる航空・宇宙・防衛分野での受注が獲得できたほか、足許でハイブリッド車に関連した新規需要が増加傾向にあることが、受注の増加の要因と考えております。
- なお、計測機器のデータも補足情報部分に記載しております。

## 貸借対照表

固定資産・棚卸資産が増加、売上債権が減少、総資産は前期末比で横ばい

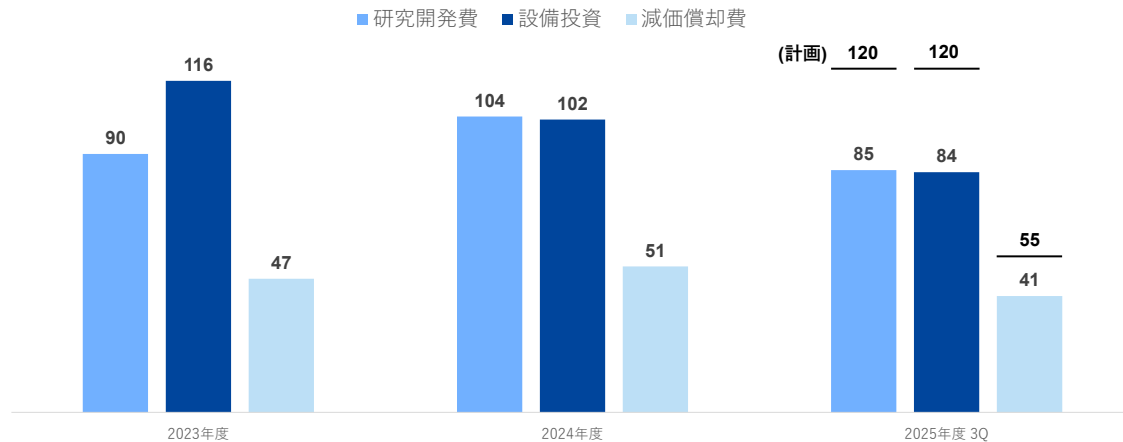


- 6ページは貸借対照表の説明になります。
- 2025年12月末の総資産は、2,379億円となり、ほぼ前期末と同水準となりました。
- 左側、資産の部ですが、工場竣工などにより固定資産が増加しているほか、第4四半期だけではなく、今後の出荷増が想定されるため、棚卸資産を積み増した結果、増加しました。一方で、売上債権は回収のサイト短縮に取り組んでいることなどから、減少しました。
- 右側、負債・純資産の部については、10-12月期にも長期借入金の返済があったことで、負債が減少しました。この結果、12月末の自己資本比率は75.3%となりました。

## 研究開発費・設備投資・減価償却費

第3四半期までは概ね計画線の推移。2025年度計画に変更なし

(億円)



7 @ TOKYO SEIMITSU

ACCURETECH | 東京精密

- 7ページは研究開発費、設備投資、減価償却費の説明です。
- 実績は棒グラフで示している通りです。右側、今年度 第3四半期までは概ね想定通りの推移となりました。
- 横線で示しているのが2025年度の通期計画です。11月公表の計画からの変更はございません。
- ここまでが、2025年度第3四半期の実績の説明となります。
- 私からの説明は以上となります。続いて、今後の計画や見通しなどについて、CEOの木村より説明いたします。

## 2025年度通期業績予想前提、2026年度の考え方(青字:2月変更)

### 2025年度売上高・営業利益

半導体：引き続き生成AIを含むHPC案件の売上が貢献

計測：高水準を維持、下期は特に航空宇宙・防衛関連が堅調

利益：引き続き 部材調達価格・経費等の上昇の影響を受ける

### 2025年度 受注高

半導体：HPC・中国ハイエンド向け需要が継続

計測：引き続き更新投資や充放電試験システムに加え、航空宇宙・防衛などの事業機会を捉える

### 2026年度の考え方

半導体：引き続き生成AIを含むHPC案件が牽引、Hybrid Bondingの貢献も期待

- 売上高は上期 < 下期、通期では市場成長に沿った増収を想定。上期の受注高は2025年度下期比増加を見込む
- Hybrid Bonding向けグラインダは2026年度下期以降の業績に貢献する想定を据え置き

計測：更新投資、航空・宇宙・防衛などの新規需要、ものづくり市場全般の回復を前提に 緩やかな成長基調を維持

利益：付加価値を高め、コスト上昇圧力を可能な限り吸収(中期経営計画<sup>(\*)</sup>)の前提に沿った利益率改善を狙う)

(\*) 2025年度 - 2027年度 中期経営計画

[https://www.accretech.com/jp/ir/library/presentation/main/06/teaserItems1/00/linkList/00/link/MTP\\_2025\\_J\\_2.pdf](https://www.accretech.com/jp/ir/library/presentation/main/06/teaserItems1/00/linkList/00/link/MTP_2025_J_2.pdf)

- 代表取締役社長CEOの木村です。お世話になっております。私からは、今年度の計画と、今後の見通しについて説明いたします。
- まず8ページです。上段の今年度 売上高・営業利益、ならびに中段の受注高の見方に関しては、11月からの変更はございません。引き続き生成AIを含むHPC向けの出荷が、売上や利益をけん引する見込みです。この第4四半期はかなり強い売上高となる見込みです。
- 下段に、2026年度の考え方を記載しました。半導体は、引き続き生成AIを含むHPC案件が業績をけん引すると想定しております。2026年度の業務計画は現在策定中ですが、現時点では、2026年度上期より下期の方が大きな売上高となり、年度ベースでは市場成長に沿った増収で着地するイメージを持っています。これをけん引する上期の受注ですが、HPCを中心に、この下期比で増加する見通しです。また下期には、ハイブリットボンディング向けグラインダの受注が貢献してくると想定しています。
- 計測機器も、引き続き更新投資や、航空・宇宙・防衛などの新規需要獲得を通じて、業容拡大を狙っていきます。ものづくり市場全般の回復基調も見えていきますので、セグメント全体でみると 2026年度も緩やかな成長基調が維持できるとみています。
- 利益面は大きな課題です。製品の付加価値を高め、トップラインを拡大することや、原価改善を通じて、利益率を中期経営計画の前提に近づけていきたいと考えています。

## 2025年度通期業績予想

2025年11月4日に公表した通期業績予想を修正

(第4四半期の出荷・売上・経費計画を踏まえ上方修正)

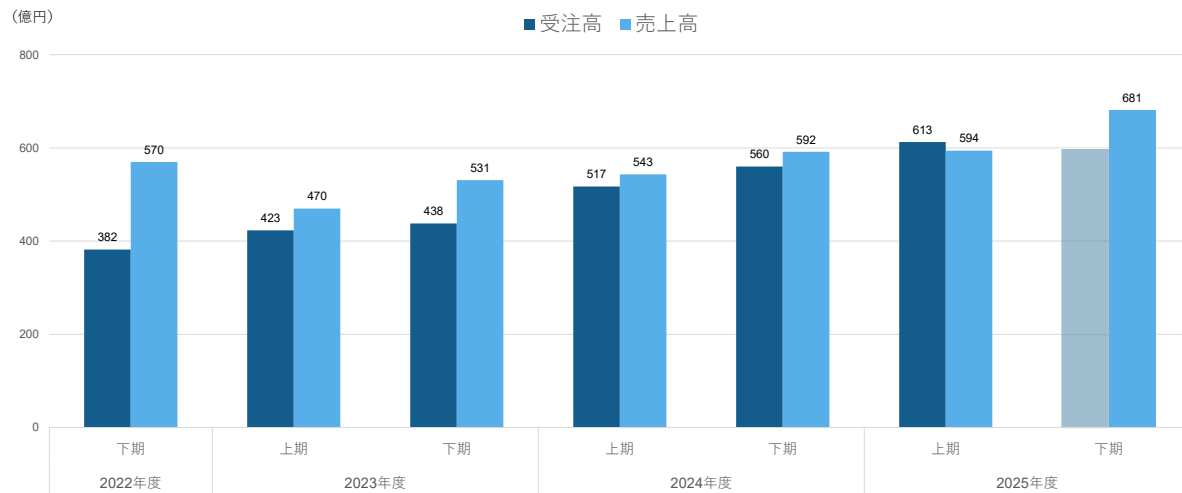
前提為替レートは140円/ドルを据え置き (為替変動影響は軽微：円建て比率高)

全社業績(億円)	2024年度通期				2025年度通期 予想				前回予想増減	前期比
受注高	1,456				-				-	-
売上高	1,505				1,650				+10	+10%
営業利益	297				320				+5	+8%
(利益率)	(20%)				(19%)				±0pt	-0pt
経常利益	299				320				+5	+7%
当期純利益	256				215				+10	-16%
研究開発費	104				120				±0	+16%
設備投資	102				120				±0	+17%
減価償却費	51				55				±0	+8%
セグメント別売上高	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	2025-2Q	2025-3Q	2025-4Q予	前回予想増減	
半導体製造装置	220	323	230	361	235	359	274	407	+5	
計測機器	76	95	87	113	73	103	85	113	+5	
1株配当(円)	253円				222円				-	-31円

- 9ページは、2025年度の業績予想を説明しています。
- この第4四半期の生産・出荷計画、ならびに経費の見通しを試算したところ、11月予想に対して若干上振れの着地が見込めたため、売上高は半導体・計測ともに5億円、全社で10億円 上方修正しました。
- これに伴い、営業利益・経常利益をそれぞれプラス5億円、純利益をプラス10億円 上方修正しました。
- なお、年間配当予想に変更はありません。
- 前提為替レートは、1ドル 140円を据え置いております。現時点では、為替変動による業績への変動は軽微と見積もっております。

## 半導体製造装置セグメント- 売上・受注高 半期見込

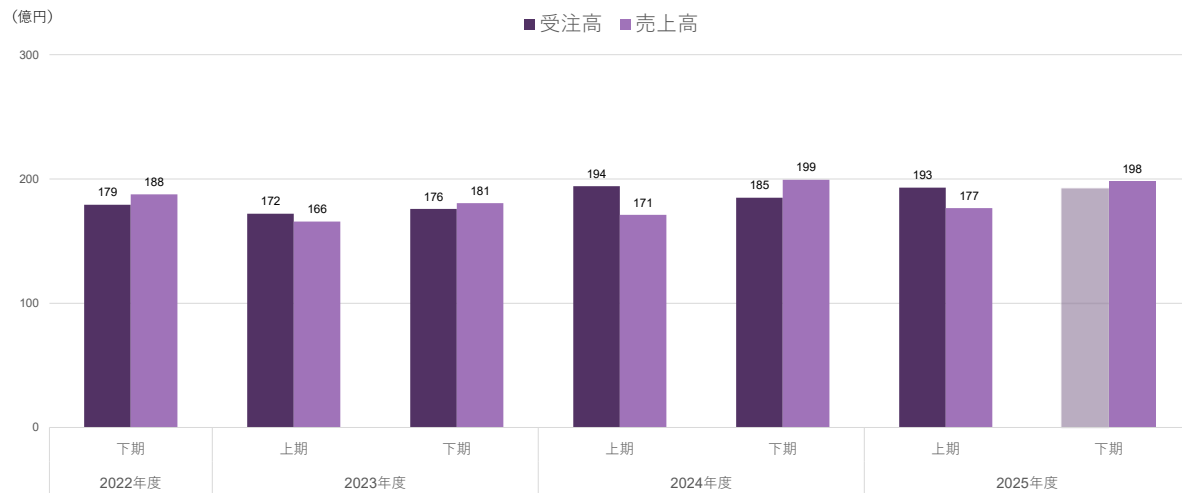
2025年度下期受注高は前年同期比で微増を想定 (上期からの反動減もあり)



- 10ページは、半導体事業の 売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 25年度下期の受注高は、前年同期比で横ばいの想定です。
- 引き続き、生成AIを含むHPC需要が中心となる想定しております。
- 下期予想の製品構成比は、売上高・受注高ともに、  
検査装置 6割半ば、加工装置3割半ばを想定しています。

## 計測機器セグメント－売上・受注高 半期見込

2025年度下期受注高は前年同期比横ばいを想定



- 11ページは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 11月の見込みから変更はなく、25年度下期の受注高は、前年同期比で横ばいの想定です。
- 下期予想の製品構成比は売上高は、汎用計測 7割、自動計測が2割半ば、残りが充放電試験システム、受注高は、汎用計測 6割前半、自動計測が2割後半、残りが充放電試験システムの想定です。
- 以上で私からの説明を終わります。ご清聴 ありがとうございました。

## 質疑応答 / Q&A

## Supplementary Data - 生成AIを含むHPC / HPC-related business incl. Gen.AI

### <売上高/Sales>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期(11月予) FY2026/3 2H (as of Nov.)	2025年度下期(2月予) FY2026/3 2H (as of Feb.)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +55% HoH	前半期比 +66% HoH	前半期比 +34% HoH
うちロジック (生成AIを含む) of which Logic (incl. Gen AI)	前半期比 +81% HoH	前半期比 +4% HoH	前半期比 +28% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +28% HoH	前半期比 +158% HoH	前半期比 +45% HoH
SPE売上高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE sales	30%強 / Low 30%	40%半ば / Mid-40%	30%後半 / High-30%

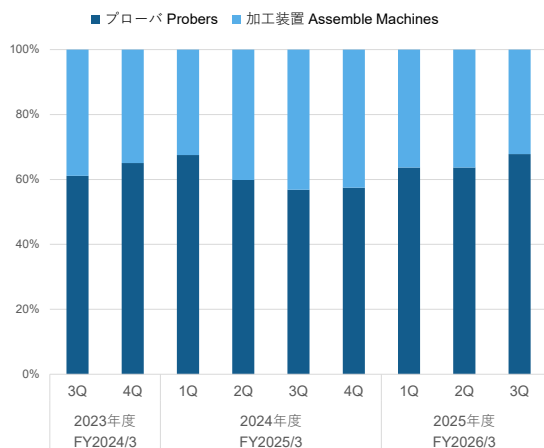
### <受注高/Orders>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期(11月予) FY2026/3 2H (as of Nov.)	2025年度下期(2月予) FY2026/3 2H (as of Feb.)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +24% HoH	前半期比 -12% HoH	前半期比 +4% HoH
うちロジック (生成AIを含む) (*) of which Logic (incl. Gen AI) (*)	前半期比 -11% HoH	前半期比 +28% HoH	前半期比 +79% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +65% HoH	前半期比 -37% HoH	前半期比 -44% HoH
SPE受注高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE orders	40%	30%半ば / Mid-30%	40%強 / Low-40%

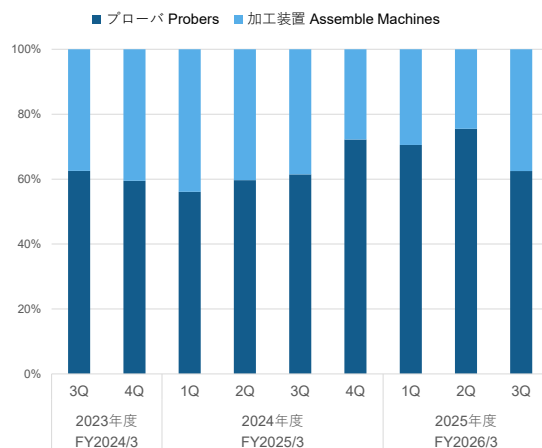
- 変動が大きいため、四半期別の開示は行っておりません。 Due to significant volatilities, the Company does not provide quarterly forecasts.
- 『生成AIを含むHPC全体』は、「うちロジック(生成AIを含む)」および「うちHBM」の合計です。「うちロジック(生成AIを含む)」には、ロジックデバイス向けプローバやAIパッケージング向けの加工装置の需要が含まれています。なお、当社は製品の特性上、検査や加工がおこなわれる半導体デバイスの種別を特定することが困難であることから、生成AIに限定した分類は行っておりません。\*HPC-related incl. Gen.AI\* represents the sum of 'of which Logic (incl. Gen.AI)' and 'of which HBM'. The 'of which Logic (incl. Gen. AI)' encompasses businesses for probers for logic devices and assembly equipment for AI packaging. Note that due to the nature of our products, it is difficult to identify the specific types of semiconductor devices undergoing inspection or processing; consequently, the Company does not undertake classification limited solely to Generative AI.

## Supplementary Data - 製品別構成比 半導体 / SPE Segment per Product

<売上高 Sales>

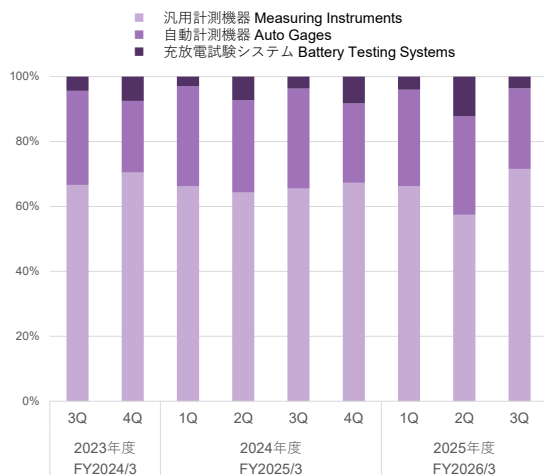


<受注高 Orders>

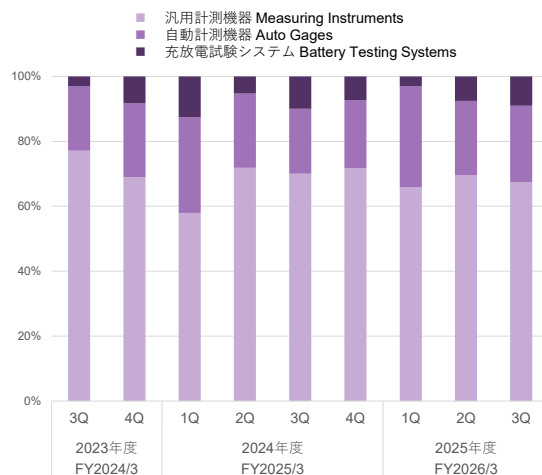


## Supplementary Data - 製品別構成比 計測 / Metrology Segment per Product

<売上高 Sales>

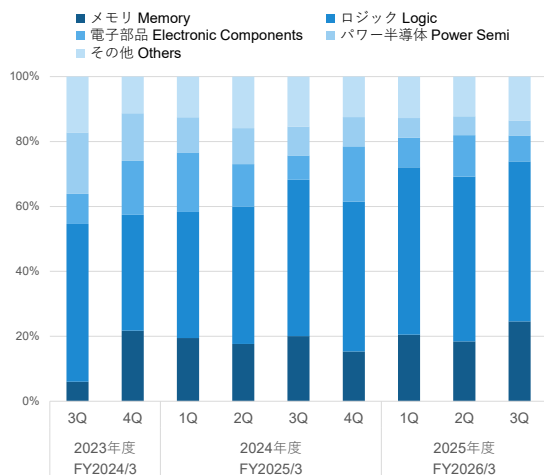


<受注高 Orders>

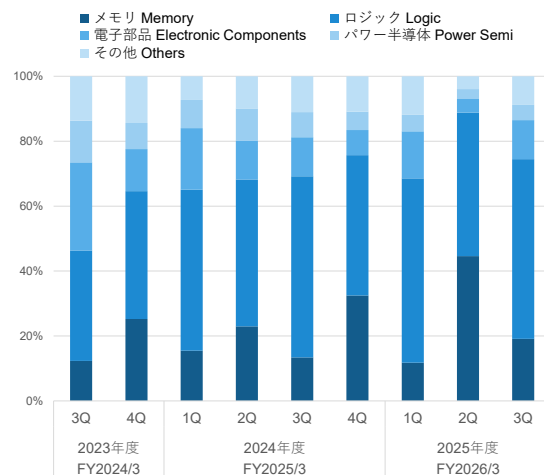


## Supplementary Data - アプリ別構成比 半導体 / SPE Segment per Application

<売上高 Sales>

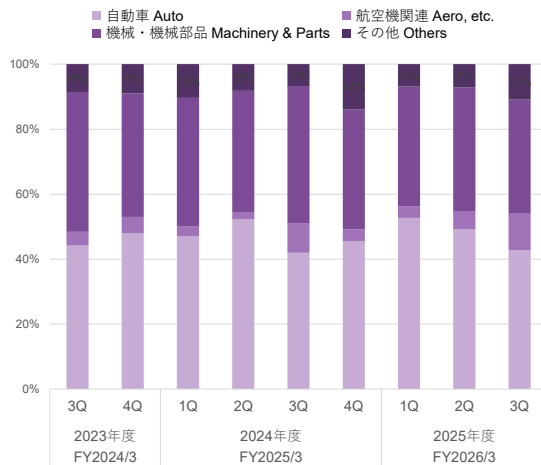


<受注高 Orders>

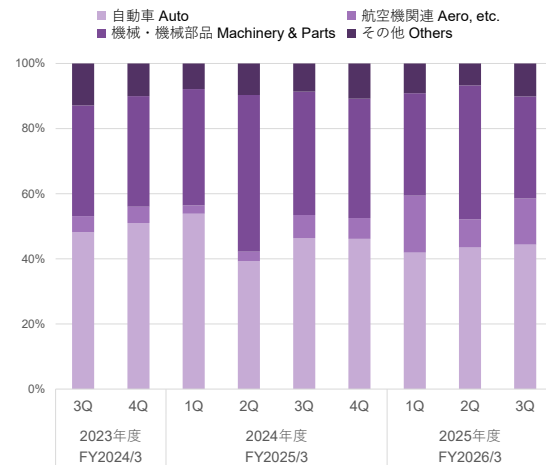


## Supplementary Data - アプリ別構成比 計測 / Metrology Segment per Application

<売上高 Sales>

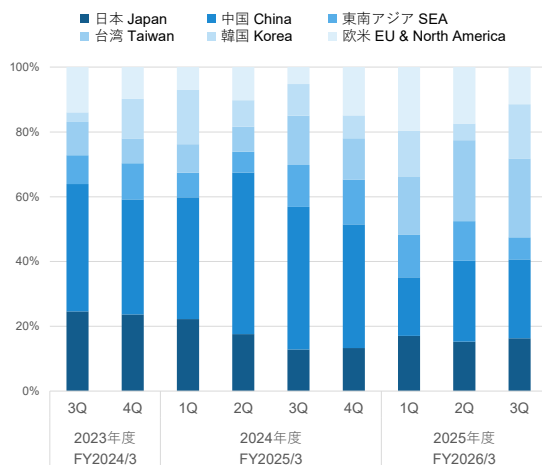


<受注高 Orders>

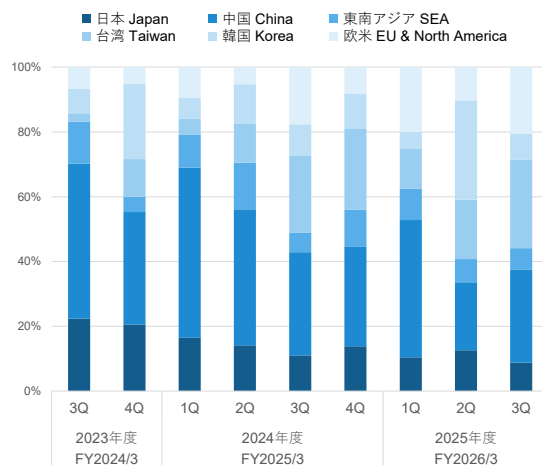


## Supplementary Data - 地域別構成比 半導体 / SPE per Region

<売上高 Sales>



<受注高 Orders>



## Supplementary Data - 地域別構成比 計測 / Metrology per Region



## Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上 増減	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	27,081	24,631	29,456	26,544	26,378	34,945	25,965	
	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	10,336	9,082	9,781	8,717	9,523	9,786	10,661	
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	37,417	33,713	39,237	35,262	35,901	44,732	36,627	
バック ログ増減	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	80,433	72,785	79,205	69,630	72,466	71,541	70,134	
	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	15,362	14,911	16,031	13,470	15,660	15,123	17,257	
	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	95,796	87,697	95,236	83,101	88,127	86,664	87,391	
売上 減	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	22,046	32,280	23,036	36,118	23,542	35,870	27,372	
	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,580	9,532	8,661	11,278	7,333	10,323	8,528	
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194	35,900	
オペ レーション増減	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,314	7,824	4,449	8,722	4,031	8,297	5,347	
	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	768	1,497	1,220	1,905	549	1,838	867	
	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136	6,214	
営業 利益率増減	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%	17.1%	23.1%	19.5%	
	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%	7.5%	17.8%	10.2%	
	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%	14.8%	21.9%	17.3%	

## Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194	35,900	
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	17,753	24,757	17,960	27,609	18,468	27,411	21,063	
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,873	17,054	13,738	19,787	12,407	18,783	14,837	
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	7,790	7,732	8,067	9,159	7,825	8,647	8,622	
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136	6,214	
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	287	39	539	55	133	309	609	
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	41	531	-422	534	252	-69	84	
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,329	8,829	6,632	10,148	4,462	10,515	6,739	
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	10	4,483	0	0	3	85	105	
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	-	157	0	-	2,103	-	
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,339	13,312	6,474	10,148	4,465	8,498	6,844	
法人税等合計 Total Income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	754	3,310	1,870	2,596	1,228	2,090	2,268	
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	31	6	29	39	7	25	39	
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,554	9,996	4,574	7,512	3,229	6,382	4,536	
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	87.89	247.09	113.07	185.67	79.77	157.32	112.74	
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-	-	-	

## Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円) (Million Yen)		2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(3Q末) FY2026/3(3Q)
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	40,080	36,782	54,541	50,680
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	43,403	42,801	39,809	35,089
	棚卸資産 Inventories	53,482	67,225	69,513	73,717
	その他 Others	7,005	7,022	5,477	5,335
	合計 Total	143,972	153,831	169,341	164,823
固定資産合計 Total Fixed Assets		65,060	71,693	68,610	73,043
総資産 Total Assets		209,032	225,524	237,952	237,866
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	22,359	17,845	16,665	18,982
	その他 Others	28,588	28,156	30,268	27,108
	合計 Total	50,947	46,002	46,933	46,091
固定負債合計 Total long-term liabilities		12,057	21,094	14,789	10,837
負債合計 Total Liabilities		63,004	67,097	61,723	56,929
純資産合計 Total Net Assets		146,028	158,427	176,229	180,937
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		209,032	225,524	237,952	237,866
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		14,191	25,171	20,084	15,720
自己資本比率 Equity Ratio(%)		69.0%	69.4%	73.2%	75.3%
自己資本利益率 ROE(%)		17.3%	12.9%	15.5%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む  
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む  
Incl. Electronically recorded obligations-operating

## Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(3Q末) FY2026/3(3Q)
研究開発費 R&D expenses	8,542	9,042	10,354	8,473
設備投資 Capex	9,725	11,602	10,245	8,402
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,832	4,673	5,105	4,073

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(上期) FY2026/3(1H)
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	1,000	4,892	28,824	16,837
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,421	-10,563	2,541	-7,337
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-7,421	-5,671	31,365	9,500
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-2,174	1,616	-13,991	-8,498
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	625	755	404	-158
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	40,036	36,736	54,516	55,359

(人数) (# of People)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(3Q末) FY2026/3(3Q)
正社員合計 Total regular employees	2,468	2,658	2,767	2,889
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (※1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,258	1,225	1,258	1,361
従業員合計 (※1) Number of employees	3,726	3,883	4,025	4,250